

苏州锘威特半导体股份有限公司

关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州锘威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2026 年度拟计划向银行申请综合授信总额不超过人民币 2.5 亿元，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押或其他担保方式，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。具体明细如下：

序号	银行	拟申请授信额度（万元）
1	招商银行股份有限公司	5,000
2	上海浦东发展银行股份有限公司	5,000
3	浙商银行股份有限公司	3,000
4	苏州银行股份有限公司	3,000
5	宁波银行股份有限公司	3,000
6	中国工商银行股份有限公司	2,000
7	中国银行股份有限公司	2,000
8	中国农业银行股份有限公司	1,000
9	江苏银行股份有限公司	1,000
	合计	25,000

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述额度可在各银行或新增银行之间调剂使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度和时间范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司董事会提请股东会授权经营管理层代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司

董事会

2026年4月10日